

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

澄清公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(“上市規則”)第 13.09(1)條規定的披露責任而作出。

中國上海，2011 年 3 月 16 日 — 中芯國際集成電路製造有限公司(以下簡稱“中芯國際”，紐約證交所代碼：SMI，香港聯交所代碼：0981.HK)，今天發佈如下聲明：

財務長曾宗琳先生表示：“基於未來企業年收入達 50 億美元的發展規劃，中芯國際未來幾年預計投入 120 億美元，用於擴大產能。資金來源或以公司現金收入為主，其餘部分或由銀行長期貸款和外部股權投資。上述規劃基於公司目前現狀，未來實際資本開支將根據(其中包括)具體市場情況、公司的業務計畫和客戶需求作適度調整。”

謹請投資者及股東注意，於本公佈日期，本公司尚未就上述規劃訂立任何需要按上市規則公佈的確切協議，因此，上述融資規劃可能或未必進行。本公司將於須要時遵守上市規則規定的責任。股東及有意投資者於買賣股份時應審慎行事。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45/40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致

中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯于加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一零年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

中芯國際集成電路製造有限公司

王寧國博士

總裁、首席執行官兼執行董事

中國上海，二零一一年三月十六日

* 僅供識別